

证券代码：603920

证券简称：世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称 与人数	九泰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、招商证券、兴业证券、中银证券、国泰海通、浙商证券、华金证券、中泰证券、甬兴证券、中原证券、东方财富证券、方正证券、天风证券、民生证券、华泰证券、国海证券、南京证券、国投证券、中信建投证券、华福证券、渤海证券、山西证券、国元证券、华源证券、太平洋证券、深圳民沣证券私募基金、南京金友私募基金管理有限公司、深圳市二进制资产管理有限公司、北京泽铭投资有限公司、浙江富春股权投资、粤佛私募基金管理（武汉）有限公司、宁波宝隽资产管理有限公司、上海智晶私募基金管理有限公司、上海翀云私募基金管理有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、广东君心盈泰投资管理有限公司、上海鹤欧投资管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、南通乐洵私募基金管理有限公司、上海德晟百川私募基金管理有限公司、耕霖（上海）投资管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、淡水泉（北京）投资管理有限公司、宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）、上海明河投资管理有限公司、太和致远私募基金管理有限公司、锐方（上海）私募基金管理有限公司、广东荣炜基业私募证券基金管理有限公司、深圳国源信达资本管理有限公司、Grand alliance、众安在线财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、中金资管、金科投资、福建三松集团有限公司、东坤资产管理有限公司、云禧（北京）投资基金管理有限公司、深圳鑫镗投资合伙企业（有限合伙）、深圳市盛钧投资管理有限公司、上海康晟佳泽投资管理有限公司、天弘基金管理有限公司、华西证券、平安证券、长城证券、华鑫证券、上海证券、开源证券、西部证券、中金公司等共 78 家机构。
时间	2025 年 8 月 27 日 15:30—16:50
地点	公司会议室

形式	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：余英杰先生 董事、副总经理：王鹏先生 董事、财务总监：蒋毅先生 董事会秘书：尹嘉亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容： （一）公司对经营情况进行介绍 1. 公司新定位及发展战略 公司成立 40 周年，今年对自身定位进行升级调整。在 AI 浪潮下，当前 PCB 行业主要沿技术路径与材料升级的二维平面持续迭代，未来 PCB 行业将向以 PCB 为主体，结合先进封装技术与工艺的三维平面进行拓展。目前，公司已探索出二维向三维增长行业拓展路径，立足汽车电子，为高可靠性场景提供硬件集成方案，并希望用“科技驱动电子电路产业健康可持续发展”，通过“技术协同+产业链整合”双轮驱动，构建“PCB-半导体-封装”一体化能力。 2. 产能布局与新基地规划 公司现有硬板产能集中于江门鹤山总部，新建产能规划分布于泰国及江门两地。泰国正在建设先进制程产业园，今年 6 月厂房已封顶，正处于机电设备安装阶段，预计 2025 年 12 月正式投产。下半年，公司拟投资 15 亿元建设“芯创智载”新一代 PCB 制造基地，生产芯片内嵌式 PCB（埋芯产品）和提升高阶 HDI 产品产能。高阶 HDI 结合芯片封装，有望进一步提升公司在 PCB 制造及半导体领域的综合竞争力。 3. 芯片内嵌式 PCB 封装技术工艺原理及性能 芯片内嵌式 PCB 封装技术是基于 2022 年广东省发改委批复的创新平台开发，其技术优势是，与传统打线封装相比，系统集成能力提高，续航里程提升明显。此外，该工艺实现了良好的散热效果和面积节约，在大功率芯片及消费类电子领域有广泛的需求前景。 4. 上半年经营业绩情况

上半年，公司总营收达 25.79 亿元，同比增长 7.64%；归属母公司净利润为 3.84 亿元，同比增长 26.89%。经营现金流规模超过净利润，且同比增长 29.93%。公司毛利率同比基本持平。

上半年，国内外市场拓展情况亮点较多。老客户需求进一步挖掘，并新增多个重量级客户。在 AI 业务方面，通过 OEM 方式进入 Nvidia 和 AMD 的供应链体系实现量产交付及持续参与新一代产品研发。新兴领域布局方面，在人形机器人、低空飞行等产品领域推进项目定点和转量产准备，人形机器人相关技术储备丰富。

5. 未来发展目标与规划

公司未来聚焦芯片内嵌式 PCB 封装技术，该技术连接线路板与半导体，可使相同电池续航能力有所提升，带来性能改变与多方面优势。技术研发上，公司积累了四五年经验，获客户认可，准备量产，未来增长空间大。产品可应用于新能源汽车、人工智能供电、储能、无人机、机器人等。

基于海外客户占比高，考虑客户对供应链安全及关税问题的反馈，客户希望加快海外产能推进。泰国项目目前推进员工招聘、管理流程优化、自动化导入等前期工作，旨在提升生产效率。整体产能策略为国内与海外双备份，保障客户供应链安全。

（二）互动交流情况

Q1. 上半年公司整体业务结构目前处于什么状态？今年下半年至明年整体业务结构的变化趋势如何？

今年上半年业务结构出现调整：AI 及服务器产品、储能及工控业务占比有所增加。未来，AI 市场增量主导行业增长，预计其占比将持续扩大；消费类以软板为主，作为传统业务将保持稳定或小幅下降；汽车电子与储能业务的占比可能因 AI 的增速而略有下降，但产品结构往高端发展。

Q2. 芯片内嵌式 PCB 封装技术的未来应用规模及适用场景如何？

芯片内嵌式 PCB 封装技术本质是半导体封装技术，是能够突破现有 PCB 物理边界的技术。传统 PCB 无论层数、阶数或材料如何升级，始终局限于

PCB 本身。而埋嵌工艺通过将芯片、电感等元器件埋嵌于 PCB 内部，形成综合解决方案，整合了上下游产业链价值。

Q3. 芯片内嵌式 PCB 封装技术的未来应用规模及适用场景如何？

目前芯片内嵌式 PCB 封装技术主要应用于大功率第三代及第三代半导体，解决其散热瓶颈。最早成熟的应用场景包括新能源车三电、英伟达 800 伏 HVDC 电源模块等使用第三代及第三代半导体的领域；小型化场景包括 AI 眼镜、苹果 TWS 耳机、折叠手机等。未来会在电动车、服务器电源中出现应用，或者扩展至小型化消费电子，甚至 GPU 大芯片也可能实现埋嵌。

Q4. 芯片内嵌式 PCB 封装技术目前存在哪些技术瓶颈？整体良率水平及未来提升空间如何？行业头部公司在该领域良率较低、占用产能的情况下，如何看待相关布局？

芯片内嵌式 PCB 封装技术的瓶颈主要体现在三方面：一是需对碳化硅芯片晶圆进行定制化处理，依赖半导体封装产能；二是埋嵌工艺要求 PCB 与芯片无缝对接以实现最短连接距离，需采用散热材料混合压合的 PCB 材料，并设计非对称 HDI 结构，对加工精度和专用 HDI 产能要求高；三是需补充半导体测试设备产能。该工艺横跨 PCB 加工与半导体封装，涉及材料、工艺的三维技术整合，工艺难度大且占用产能。目前行业内仅少数 PCB 企业具备量产能力，公司目前已完成车厂新产品定型，预计明年第一期产能释放并逐步实现批量供货。

Q5. 珠海世运下半年的经营展望具体如何？上半年亏损金额是多少？

珠海世运上半年亏损约 3,866.65 万元。公司对珠海世运在市场拓展、技术研发、运营协调、资源调配等方面制定针对性地整合措施，积极采取多种方式改善珠海世运的经营状况。除了消费电子外，公司也积极为珠海世运引入其他领域客户，包括新能源汽车、低空飞行、AI 智能眼镜等，通过公司与珠海世运的资源整合，共同发展相关新兴业务，寻求第二增长曲线，目前已经取得一定成果。月度订单量持续提升，预计下半年经营情况将显著优于上半年。

Q6. 关于特斯拉服务器芯片，近期变动的具体情况如何？客户是否给出了

	相关指引或说明？ 特斯拉近期解散了 DOJO2 研发团队，由于 AI5、AI6 芯片性能优异，可同时用于推理和训练，特斯拉决定停止双线推进，取消 DOJO 项目，将核心算力资源集中到 AI5 和 AI6 芯片中。未来公司会紧密对接客户后续的研发安排。 Q7. 公司目前涉及的 AI 相关业务主要包括哪些内容？ 公司 AI 相关业务覆盖国内外客户，海外方面，通过 ODM 厂商进入 NV 的高速连接器模块与电源模块领域；完成 AMD 全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。国内方面，为多家国产算力厂商的 GPU 相关产品提供研发支持。此外，还涉及边缘产品，如网卡板、控制板及服务器通信小模块。公司客户群庞大，订单饱满。 Q8. 三季度公司稼动率与二季度相比情况如何？ 公司稼动率持续处于较高水平。由于产品结构不断升级，未来产值与利润增长将主要依赖工厂效率提升。二季度承接大量高端订单，初期因产线调配与工人学习成本未完全适应，但随着熟练度提升，生产效率预计逐季度改善。 Q9. 公司与具备载板技术的企业相比，优势及技术特点体现在哪些方面？ 载板工艺与埋嵌芯片技术是有区别的。友商在载板工艺上可能技术领先，该工艺属于 PCB 加工技术，实现更低线宽线距；而公司的埋嵌芯片技术涉及多维度，不仅是 PCB 制程，更需要对芯片封装的理解。 Q10. 如何看待下半年至明年汽车行业景气度及价格情况，海外客户是否会受国内新势力降价影响？ 公司产品未受价格明显影响。当前 PCB 景气周期高、产能紧缺，下游终端客户选择供应商的优先级为：供应链安全性、产品一致性、产能、技术、价格。从终端产品看，海外客户和国内客户情况向好，公司汽车业务边际持续改善，对今年下半年及明年汽车板块收入持乐观态度。 Q11. 除了汽车业务外，储能业务下半年的景气度如何？
--	---

	储能产品相关的线路板是公司目前及未来重点发展方向之一。客户储能产品市场优势显著，海外市场份额超 25%，受益于算力中心及新能源基地储能配套需求，产能持续补足，未来几年将保持高增长。随客户出货量的增长，将带动公司储能业务增长。 Q12. 公司未来的发展重点领域、目标是怎样的？ 公司与顺控合作进展顺利，未来经营将按原定目标推进。当前重点布局新项目投资，聚焦线路板与半导体连接的新技术，该技术可显著提升电池续航能力并带来多方面的性能优化。未来三年，公司产品方向将在 PCB 基础上拓展半导体领域，增加相关投资，形成新的增长空间。 Q13. 公司公告的“芯创智载”项目是否对产值进行了大概估算？ “芯创智载”项目的产值估算需结合不同业务阶段分析，采用埋嵌工艺后，因减少芯片封装材料及工艺价值量、增加贴片价值量，投入产出比高于仅投 PCB 设备的水平；若包含芯片，产品价值量会有进一步提升。当前阶段主要由客户提供定制芯片进行埋嵌，未来可能自主开展定制化芯片业务。 Q14. “芯创智载”项目价值量比 PCB 高出四五倍的成品，其利润率是否能保持与当前 PCB 相当的水平？ 成品利润率需分两种情况：若仅来料加工、仅做埋嵌，理论上毛利率较高；若涉及自主芯片供应链与定制，毛利率可能略低，但价值量显著提升，整体利润增长优于原有 PCB 业务。由于芯片与产品同步出货，未来芯片运行可靠性风险与收益成正比。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件（如有）	无